

## 大面積旋轉電鑄機開發計劃

### ■ 計畫目標

開發大面積精密旋轉電鑄機

### ■ 執行成果

1. 已開發第一部大面積精密旋轉電鑄機原型。
2. 已於四家廠商洽相關合作事宜。

### ■ 新產品 / 新技術 / 新設計 / 新材料簡介

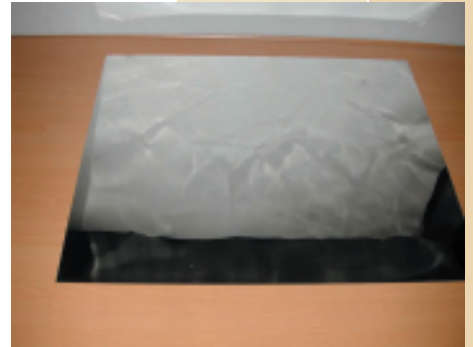
本計畫開發之大面積精密旋轉電鑄機主要是利用旋轉機制在電鑄過程中克服

目前傳統電鑄機之厚度均勻度差且電鑄時間過長之缺點：主要技術領先項目：

1. 大面積：比傳統15-20公分，新技術50\*60Cm。
2. 尺寸精度：比傳統更俱有精度。
3. 鍍層均勻度：比傳統更俱有均勻性。
4. 機構設計：更具有人性化及簡易操作特性。

### ■ 技術合作單位及合作內容

1. 轉委托單位：工業技術研究院材料研究所電子金屬組
2. 轉委托內容：
  - (1) 設計規格討論。
  - (2) 電鑄試驗。
  - (3) 修改建議。



(4) 專利構想撰寫。

## ■ 成果應用領域

### 1. 現有市場

(1) 噴墨印字頭之噴孔片

(2) CD及DVD射出模仁(stamper)

(3) LCD用導光板射出模仁

(4) 精密金屬印刷網板(metal stencil for SMT, BGA, CSP, Flip Chip)

(5) 平面顯示器製程用蒸鍍罩

(6) 牙醫及生化產品

### 2. 未來市場

(1) 晶圓銅製程(12")晶圓覆晶式封裝凸塊電鍍



## ■ 專案執行重要心得

開發完成之後，嵩展公司有機會進入微機電高科技產業，對於台灣之晶圓代工廠升級到新世代晶圓技術主流-銅製程，電子封裝廠升級到覆晶式封裝(Flip Chip)及晶圓級封裝(WLCSP)的過程中機械設備可以一起發展而踏入高科技領域之設備供應行列；同時也將公司濕式設備產品從清洗和蝕刻轉型邁入電鍍設備，提昇技術之層次。